CEI 60191-6-2
(Première édition – 2001)

Normalisation mécanique des dispositifs
à semiconducteurs –

Partie 6-2: Règles générales pour la préparation des dessins d'encombrement des dispositifs à semiconducteurs pour montage en surface – Guide de conception pour les boîtiers à broches en forme de billes et de colonnes, avec des pas de 1,50 mm, 1,27 mm et 1,00 mm

Publication monolingue (anglais)

IEC 60191-6-2
(First edition – 2001)

Mechanical standardization of semiconductor devices –

Part 6-2: General rules for the preparation of outline drawings of surface mounted semiconductor device packages – Design guide for 1,50 mm, 1,27 mm and 1,00 mm pitch ball and column terminal packages

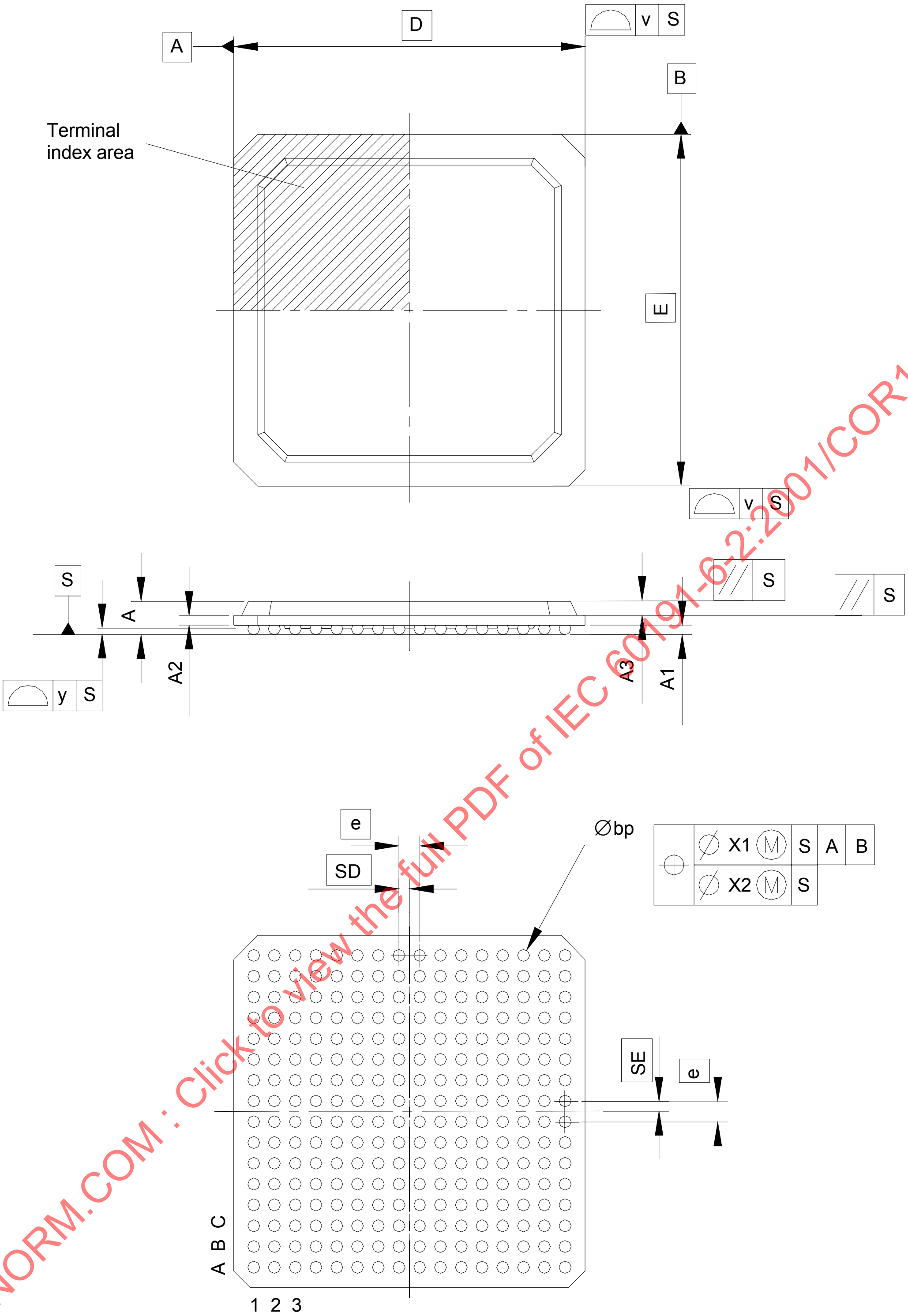
CORRIGENDUM 1

Pages 5 and 8

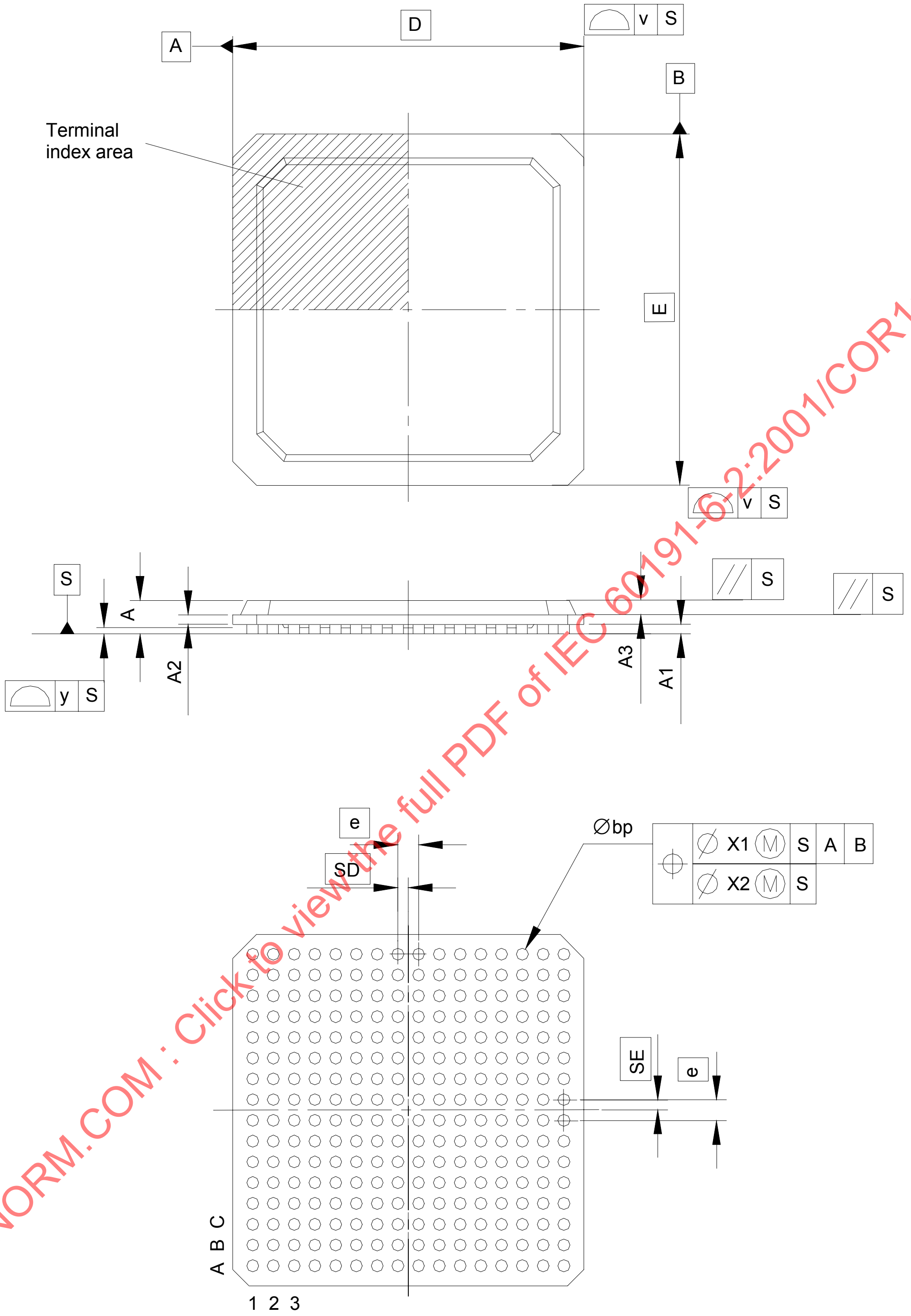
Clause 4 and clause 5

Reference characters and drawings

Replace the existing two figures by the following:


A
D
v
S
B
Terminal index area
E
v
S
S
A
A2
y
S
A3
A1
S
S
e
SD
∅bp
X1
M
S
A
B
X2
M
S
SE
e
A B C
1 2 3

IEC 2699/01


A
D
v
S
B
Terminal index area
E
v
S
S
A
A2
A3
A1
y
S
//
S
//
S
e
SD
∅bp
∅ X1 M S A B
∅ X2 M S
SE
e
A B C
1 2 3

IEC 2700/01